



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 面向 2.5D 集成的先进封装工艺与设计仿真协同方案

演讲人: 樊嘉祺 先进封装设计经理 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

演讲摘要:

随着摩尔定律趋缓,封装技术成为电子产品小型化、多功能化、降低功耗,提高带宽的重要手段。芯片封装正从传统的平面封装向着系统集成、高速、高频、三维方向发展。在芯片-封装协同设计以及为满足各种可靠性要求而使用具成本效益的材料和工艺方面,还存在诸多挑战。

华进半导体作为国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心,长期致力于系统封装设计、2.5D/3D 集成关键核心技术研发,针对行业痛点提供设计仿真、晶圆制造、系统集成、模组测试等全方位解决方案。

演讲大纲:

2.5D 技术背景与发展现状、系统集成需求以及带来的挑战、华进的设计仿真技术

适合对象:

对先进封装设计与仿真、高性能计算、系统集成感兴趣的朋友

演讲人简介:

6 年先进封装设计领域从业经验,主要从事 2.5D/3D 集成封装、晶圆级扇出封装、三维异质集成等封装设计、仿真技术研究。主导过国家级制造业创新中心设计仿真平台建设和国内首套先进封装 APDK (Advanced Process Design Kit) 开发测试工作。主持或参与多项国家级项目的课题研究任务,申请专利 10 余项。